

证券代码：300456

证券简称：赛微电子

公告编号：2024-072

## 北京赛微电子股份有限公司 2024 年半年度报告摘要

### 一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

### 二、公司基本情况

#### 1、公司简介

股票简称	赛微电子	股票代码	300456
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张阿斌	孙玉华	
电话	010-82252103	010-82251527	
办公地址	北京市西城区裕民路 18 号北环中心 A 座 2607 室、北京市北京经济技术开发区科创八街 21 号院 1 号楼	北京市西城区裕民路 18 号北环中心 A 座 2607 室、北京市北京经济技术开发区科创八街 21 号院 1 号楼	
电子信箱	ir@smeicc.com	ir@smeicc.com	

#### 2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	551,351,055.19	396,907,735.48	38.91%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-42,667,857.30	-27,440,797.46	-55.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-48,606,837.18	-61,965,834.59	21.56%
经营活动产生的现金流量净额（元）	141,413,022.35	1,426,331.00	9,814.46%
基本每股收益（元/股）	-0.0583	-0.0374	-55.88%
稀释每股收益（元/股）	-0.0583	-0.0374	-55.88%
加权平均净资产收益率	-0.83%	-0.55%	-0.28%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	7,195,114,434.50	7,261,878,738.03	-0.92%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,063,251,977.80	5,162,100,953.14	-1.91%

### 3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	62,408	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0	
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
杨云春	境内自然人	25.18%	184,346,719	138,260,039	质押	87,200,000
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	国有法人	10.06%	73,681,529	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.95%	6,950,727	0	不适用	0
国泰君安证券股份有限公司－国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.90%	6,614,033	0	不适用	0
中金期货有限公司－中金期货－融汇 1 号资产管理计划	境内非国有法人	0.76%	5,532,188	0	不适用	0
银河德睿资本管理有限公司	境内非国有法人	0.68%	4,999,981	0	不适用	0
刘琼	境内自然人	0.67%	4,875,372	0	不适用	0
杭州乐信投资管理有限公司－乐信长阳私募证券投资基金	境内非国有法人	0.41%	3,000,082	0	不适用	0
马鞍山郑蒲港新区综合保税区投资有限公司	境内非国有法人	0.37%	2,712,127	0	不适用	0
沈幼生	境内自然人	0.35%	2,560,000	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东杨云春、国家集成电路产业投资基金股份有限公司、刘琼之间不存在关联关系，亦不存在一致行动关系。除此之外，公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系或是否存在一致行动关系。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	杭州乐信投资管理有限公司－乐信长阳私募证券投资基金通过普通证券账户持有 0 股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,000,082 股，实际合计持有 3,000,082 股。					

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

单位：股

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
国泰君安证券股份有限公司—国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	7,279,776	0.99%	1,437,500	0.20%	6,614,033	0.90%	517,900	0.07%

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

公司是否具有表决权差异安排

是 否

#### 4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

#### 5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

#### 6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

### 三、重要事项

#### （一）整体经营情况概述

报告期内，公司继续聚焦发展主营业务 MEMS（微机电系统），在复杂的国际政治经济环境下，MEMS 业务实现稳健的收入增长，并持续为下一步的产能扩充及爬坡做好准备。公司主营业务 MEMS 工艺开发与晶圆制造具备全球竞争优势，拥有业内顶级专家与工程师团队，并在境内外同时布局扩张新的 8 英寸/12 英寸产能，较好地把握了下游通讯、生物医疗、工业汽车、消费电子等应用领域的市场机遇，继续保持了生产与销售旺盛的状态。

对于瑞典 MEMS 产线，报告期内订单、生产与销售状况良好，继续实现了业务增长，保持了良好的盈利能力，在推动已有产线产能利用率爬坡的同时通过添购部分设备、积极规划此前收购的半导体产业园区（土地面积为 43,771 平方米，

建筑物面积为 19,270 平方米)的未来产线建设安排,为进一步加强境外产能准备条件,以满足相关客户(尤其是欧美客户)当前与未来的工艺开发及晶圆制造需求。

对于北京 MEMS 产线,报告期内继续处于产能爬坡阶段,具有导入属性的工艺开发业务持续扩大,量产属性的晶圆制造业务进一步夯实且实现倍数增长,产能利用率显著提高,北京产线的营业收入实现较大增长,与瑞典 MEMS 产线一同对 MEMS 业务的增长部分实现相当贡献。但由于产能的持续建设和经营活动的持续扩大,产线的折旧摊销压力巨大,同时又继续保持了较高的研发强度,而获得的政府补助较去年同期大幅减少,北京 MEMS 产线继续亏损且亏损金额扩大。

报告期内,公司全资子公司赛积国际仍适度开展半导体设备业务,为公司贡献了一定体量的营业收入。

与此同时,报告期内公司销售费用、财务费用上升,研发费用继续处于较高投入水平,权益法核算的长期股权投资收益为-377.41 万元。

报告期内,公司实现营业收入 55,135.11 万元,较上年同期上升 38.91%;实现营业利润-7,153.18 万元,较上年同期下降 9.69%;实现利润总额-7,153.48 万元,较上年同期下降 9.67%;实现净利润-7,427.94 万元,较上年同期下降 21.67%;实现归属于上市公司股东的净利润-4,266.79 万元,较上年同期大幅下降 55.49%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4,860.68 万元,较上年同期亏损收窄 21.56%。报告期内,公司基本每股收益-0.0583 元,较上年同期大幅下降 55.88%;加权平均净资产收益率-0.83%,较上年同期下降 0.28%(绝对数值变动),主要是由于归属于上市公司股东的净利润同比大幅下降 55.49%。本报告期末,公司总资产 719,511.44 万元,较期初下降 0.92%;归属于上市公司股东的所有者权益 506,325.20 万元,股本 732,213,134.00 元,归属于上市公司股东的每股净资产 6.91 元,较期初基本持平。

此外,在非经常性损益方面,报告期内,公司主营业务活动陆续取得系列政府补助,其中部分补助在本报告期内补偿了部分相关成本费用或损失,公司补助收益为 750.57 万元,非经常性损益对公司当期归母净利润的影响为 593.90 万元。

## (二) 主要业务情况

### 1、MEMS 主业发展情况

报告期内,境内外子公司 MEMS 业务收入均实现增长。一方面,瑞典 FAB1 & FAB2 产线继续按计划推动新增产能的磨合、持续调试产线以实现成熟运转,继续扩大 MEMS 中试服务领域、丰富工艺组合,并通过添购瓶颈设备、积极规划此前收购的半导体产业园区等为进一步加强产能准备条件(本报告期瑞典 FAB1 & FAB2 仍处于复苏阶段, MEMS-OCS 等高单价、低产量晶圆产品的收入占比提高,综合导致其产能利用率阶段性波动);另一方面,在完成基础工艺积累的情况下,北京 FAB3 产线继续保持研发投入,结合市场需求积极突破传感、射频、光学、生物等各领域各类 MEMS 器件的生产诀窍,推动客户 BAW 滤波器、MEMS 微振镜等不同类别晶圆的试产及量产导入,为产线的产能爬坡和规模量产集聚条件。

报告期内,公司 MEMS 主业实现收入 46,685.78 万元,较上年同期上升 29.32%;其中, MEMS 晶圆制造实现收入 30,634.72 万元,较上年同期上升 32.11%, MEMS 工艺开发实现收入 16,051.06 万元,较上年同期上升 24.32%,上述变化的主要原因是:基于公司的境内外“双循环”服务体系战略以及旗下不同中试线及量产线的定位,在保证工艺开发业务前置导入的同时,瑞典 FAB1 & FAB2、北京 FAB3 在当前阶段均积极推动客户将产品导入晶圆制造阶段,以逐步适应下一阶段以规模量产为主的业务形态。

报告期内,公司 MEMS 业务的综合毛利率为 35.60%,较上年同期基本持平;其中 MEMS 晶圆制造毛利率为 34.57%,较上年同期上升 2.00%(绝对数值变动), MEMS 工艺开发毛利率为 37.55%,较上年同期上升 2.34%(绝对数值变动),上述变化的主要原因是:对于 MEMS 晶圆制造,随着 MEMS 晶圆制造业务的逐步稳定发展,原材料、人工、制造费用等形成的成本结构日趋稳定,毛利率水平趋于稳定,未来需进一步释放规模效应;对于 MEMS 工艺开发,2024 年上半年较上年同期客户产品结构相对稳定,毛利率波动较小。整体而言,瑞典产线的毛利率继续保持了较高水平,北京 FAB3 仍处于产能爬坡阶段,其 MEMS 业务的综合毛利率较上年同期明显好转但仍低于瑞典产线,公司 MEMS 业务在整体上保持了较好的毛利率水平。

报告期内,得益于 MEMS 应用市场的高景气度,并基于持续扩充的瑞典产线及北京产线,公司积极开拓全球市场,并积极承接 MEMS 工艺开发及晶圆制造订单,持续服务于包括 DNA/RNA 测序、光刻机、硅光子、AI 计算、ICT、红外热成像、计算机网络及系统、元宇宙、新型医疗设备等厂商以及通讯、生物医药、工业汽车和消费电子等各细分领域的领先企业。

报告期内，公司瑞典 FAB1&FAB2 升级改造完成后的产能逐步磨合且基于此前已收购的半导体产业园区，其自身的 MEMS 工艺开发及晶圆制造业务的产能保障能力均得到加强；公司北京 FAB3 持续扩大覆盖不同的产品及客户，积极推进产能及良率爬坡，并坚持进一步扩充产能。随着瑞典产线产能利用率的逐步恢复提升，北京产线整体运营状态的持续提升，以及公司正在推进的粤港澳大湾区、怀柔科学城中试产线布局，公司境内外同时拥有不同定位的合格产能，不同产线在产能、市场等方面的协同互补将有力保证公司继续保持纯 MEMS 代工的全球领先地位。

## 2、研发情况

报告期内，公司继续重视技术和产品的研发投入，包括人才的培养引进及资源的优先保障。公司 MEMS 主业属于国家鼓励发展的高技术产业和战略性新兴产业，也需要公司进行重点、持续的研发投入。2024 年上半年，公司共计投入研发费用 18,147.35 万元，较上年同期增加 3.25%，占营业收入的 32.91%，研发投入的规模和强度继续呈现出较高的水平。

## 3、投融资情况

报告期内，公司为更好地服务于 MEMS 主业发展，根据长期发展战略继续开展投融资活动：（1）股权投资方面，基于对光谷信息的长期投资历史及乐观展望，公司通过协议转让方式增持光谷信息 10.72%股权；（2）股权调整方面，基于海创微元的定位及中长期发展前景，公司进一步提高了对该子公司持股比例；（3）产业基金方面，持续推动北京传感基金在智能传感领域的项目投资；继续跟踪半导体产业基金、北斗产业基金的投资与投后情况，关注赛微私募基金的运行情况；（4）股权激励方面，根据公司 2021 年限制性股票激励计划操作部分股票上市以及部分股票回购注销/作废；（5）融资租赁方面，瑞典 Sillex 与赛莱克斯北京继续执行相关融资租赁交易；（6）银行授信方面，公司及子公司根据经营发展中的资金需求，继续向相关银行申请综合授信额度。